

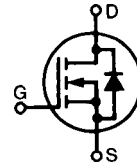
# HiPerFET™ Power MOSFETs Q-Class

**IXFH 15N80Q**  
**IXFT 15N80Q**

**V<sub>DSS</sub> = 800 V**  
**I<sub>D25</sub> = 15 A**  
**R<sub>DS(on)</sub> = 0.60 Ω**

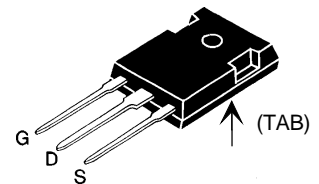
**t<sub>rr</sub> ≤ 250 ns**

N-Channel Enhancement Mode  
Avalanche Rated, High dv/dt, Low Q<sub>g</sub>

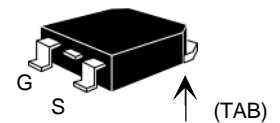


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V <sub>DSS</sub>	T <sub>J</sub> = 25°C to 150°C	800	V
V <sub>DGR</sub>	T <sub>J</sub> = 25°C to 150°C; R <sub>GS</sub> = 1 MΩ	800	V
V <sub>GS</sub>	Continuous	±20	V
V <sub>GSM</sub>	Transient	±30	V
I <sub>D25</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C	15	A
I <sub>DM</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C, pulse width limited by T <sub>JM</sub>	60	A
I <sub>AR</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C	15	A
E <sub>AR</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C	30	mJ
E <sub>AS</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C	1.0	J
dv/dt	I <sub>S</sub> ≤ I <sub>DM1</sub> , di/dt ≤ 100 A/μs, V <sub>DD</sub> ≤ V <sub>DSS</sub> , T <sub>J</sub> ≤ 150°C, R <sub>G</sub> = 2 Ω	5	V/ns
P <sub>D</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C	300	W
T <sub>J</sub>		-55 ... +150	°C
T <sub>JM</sub>		150	°C
T <sub>stg</sub>		-55 ... +150	°C
T <sub>L</sub>	1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300	°C
M <sub>d</sub>	Mounting torque	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-247	6	g
	TO-268	4	g

TO-247 AD (IXFH)



TO-268 (D3) (IXFT) Case Style



G = Gate      D = Drain  
S = Source      TAB = Drain

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
V <sub>DSS</sub>	V <sub>GS</sub> = 0 V, I <sub>D</sub> = 3 mA	800		V
V <sub>GS(th)</sub>	V <sub>DS</sub> = V <sub>GS</sub> , I <sub>D</sub> = 4 mA	2.0		4.5 V
I <sub>GSS</sub>	V <sub>GS</sub> = ±20 V <sub>DC</sub> , V <sub>DS</sub> = 0			±100 nA
I <sub>DSS</sub>	V <sub>DS</sub> = V <sub>DSS</sub> V <sub>GS</sub> = 0 V	T <sub>J</sub> = 25°C		25 μA
		T <sub>J</sub> = 125°C		1 mA
R <sub>DS(on)</sub>	V <sub>GS</sub> = 10 V, I <sub>D</sub> = 0.5 I <sub>D25</sub> Pulse test, t ≤ 300 μs, duty cycle d ≤ 2 %			0.60 Ω

## Features

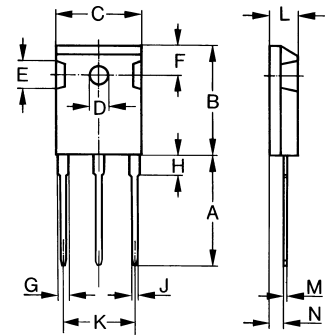
- IXYS advanced low Q<sub>g</sub> process
- International standard packages
- Low R<sub>DS(on)</sub>
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Fast switching
- Molding epoxies meet UL 94 V-0 flammability classification

## Advantages

- Easy to mount
- Space savings
- High power density

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		$(T_J = 25^\circ\text{C}, \text{ unless otherwise specified})$		
		Min.	Typ.	Max.
$g_{fs}$	$V_{DS} = 10\text{ V}; I_D = 0.5 I_{D25}$ pulse test	8	16	S
$C_{iss}$	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		4300	pF
$C_{oss}$			360	pF
$C_{rss}$			60	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = 0.5 I_{D25}$ $R_G = 1.5\ \Omega$ (External)		18	ns
$t_r$			27	ns
$t_{d(off)}$			53	ns
$t_f$			16	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = 0.5 I_{D25}$		90	nC
$Q_{gs}$			20	nC
$Q_{gd}$			30	nC
$R_{thJC}$	(TO-247)		0.42	K/W
$R_{thCK}$			0.25	K/W

### TO-247 AD (IXFH) Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	19.81	20.32	0.780	0.800
B	20.80	21.46	0.819	0.845
C	15.75	16.26	0.610	0.640
D	3.55	3.65	0.140	0.144
E	4.32	5.49	0.170	0.216
F	5.4	6.2	0.212	0.244
G	1.65	2.13	0.065	0.084
H	-	4.5	-	0.177
J	1.0	1.4	0.040	0.055
K	10.8	11.0	0.426	0.433
L	4.7	5.3	0.185	0.209
M	0.4	0.8	0.016	0.031
N	1.5	2.49	0.087	0.102

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		$(T_J = 25^\circ\text{C}, \text{ unless otherwise specified})$		
		min.	typ.	max.
$I_S$	$V_{GS} = 0\text{ V}$			15 A
$I_{SM}$	Repetitive;			60 A
$V_{SD}$	$I_F = I_S, V_{GS} = 0\text{ V},$ Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s},$ duty cycle $d \leq 2\%$			1.5 V
$t_{rr}$	$I_F = I_S - di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}, V_R = 100\text{ V}$		0.85	250 ns
$Q_{RM}$			8	$\mu\text{C}$
$I_{RM}$				

### TO-268AA (D<sup>3</sup> PAK)

Mechanical drawing of the TO-268AA (D<sup>3</sup> PAK) showing dimensions A through L4. The drawing includes a top view, a side view, and a perspective view. Dimensions are labeled as follows: A (height), A1 (height to top of case), A2 (height to top of case), b (width of case), b2 (width of case at base), C (width of case), D (height of case), E (height of case), E1 (height of case), e (height of case), H (height of case), L (height of lead), L1 (width of lead), L2 (width of lead at base), L3 (width of lead), and L4 (width of lead at base).

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.9	5.1	.193	.201
A <sub>1</sub>	2.7	2.9	.106	.114
A <sub>2</sub>	.02	.25	.001	.010
b	1.15	1.45	.045	.057
b <sub>2</sub>	1.9	2.1	.75	.83
C	.4	.65	.016	.026
D	13.80	14.00	.543	.551
E	15.85	16.05	.624	.632
E <sub>1</sub>	13.3	13.6	.524	.535
e	5.45 BSC		.215 BSC	
H	18.70	19.10	.736	.752
L	2.40	2.70	.094	.106
L <sub>1</sub>	1.20	1.40	.047	.055
L <sub>2</sub>	1.00	1.15	.039	.045
L <sub>3</sub>	0.25 BSC		.010 BSC	
L <sub>4</sub>	3.80	4.10	.150	.161

### Min. Recommended Footprint

Mechanical drawing of the Min. Recommended Footprint showing dimensions 0.500, 0.653, 0.197, 0.531, 0.864, 0.118, and 0.215. The drawing includes a top view and a side view. Dimensions are labeled as follows: 0.500 [12.70], 0.653 [16.59], 0.197 [5.00], 0.531 [13.49], 0.864 [21.95], 0.118 [3.00], and 0.215 [5.46].

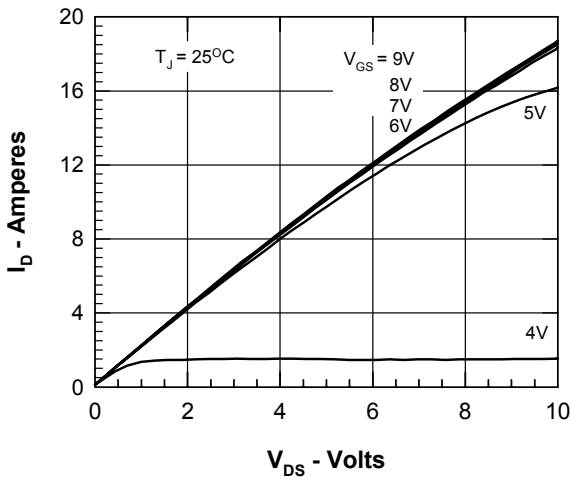


Figure 1. Output Characteristics at 25°C

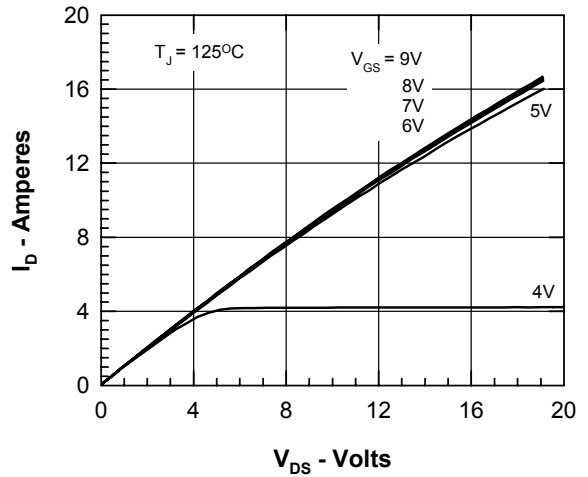


Figure 2. Output Characteristics at 125°C

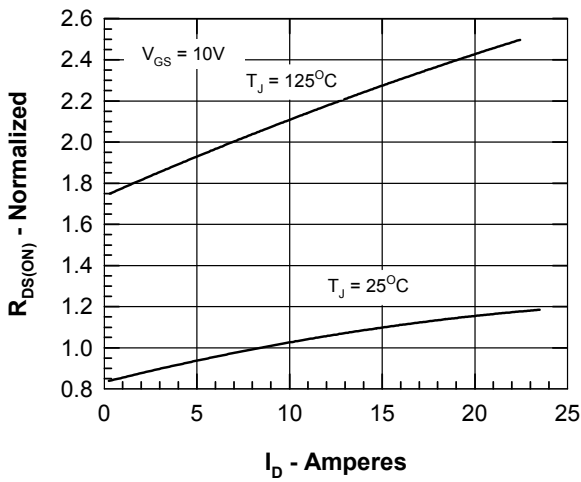


Figure 3.  $R_{DS(on)}$  normalized to value at  $I_D = 12A$

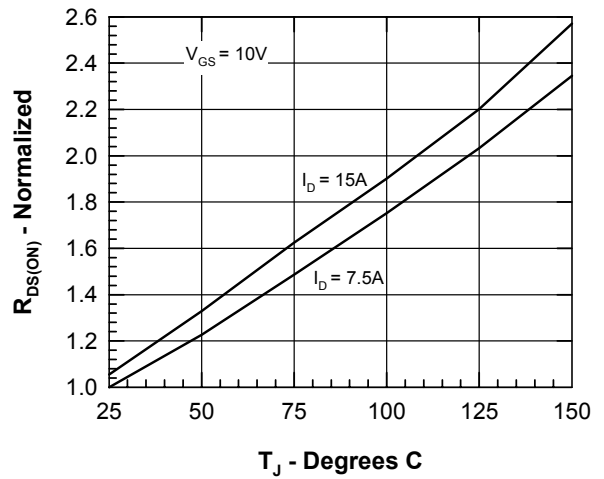


Figure 4.  $R_{DS(on)}$  normalized to value at  $I_D = 12A$

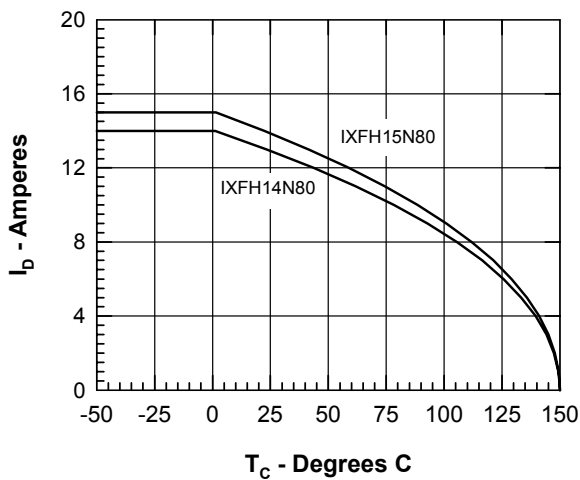


Figure 5. Drain Current vs. Case Temperature

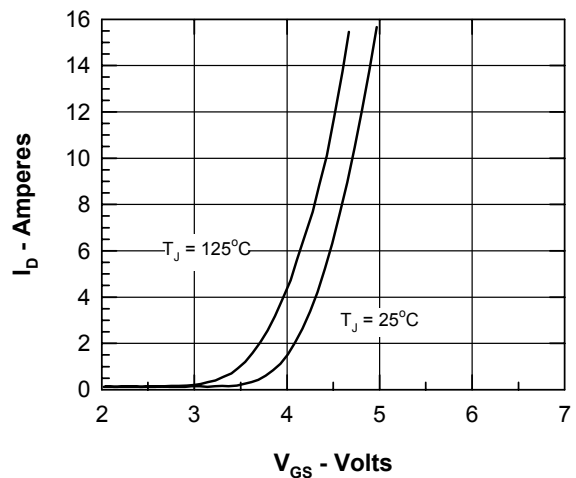


Figure 6. Admittance Curves

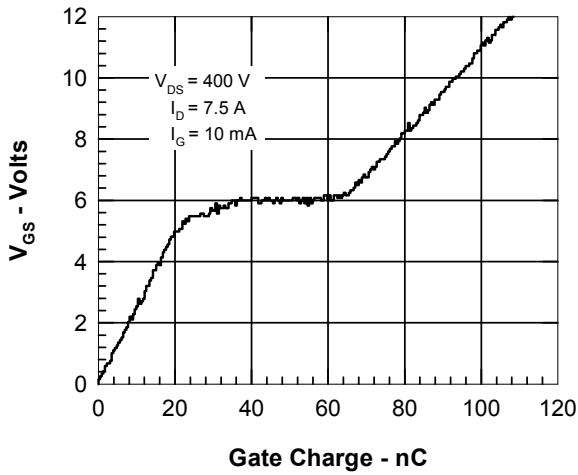


Figure 7. Gate Charge

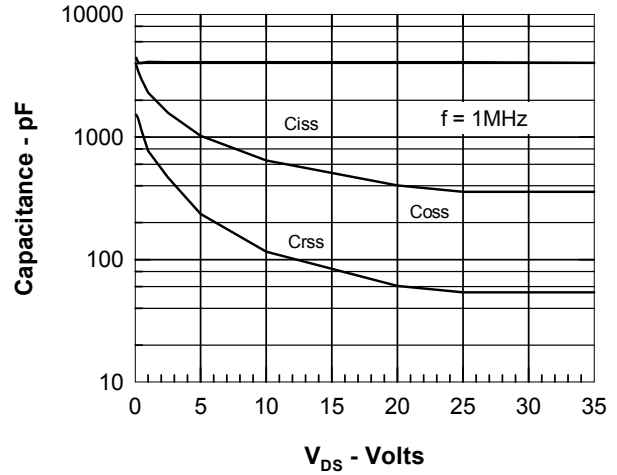


Figure 8. Capacitance Curves

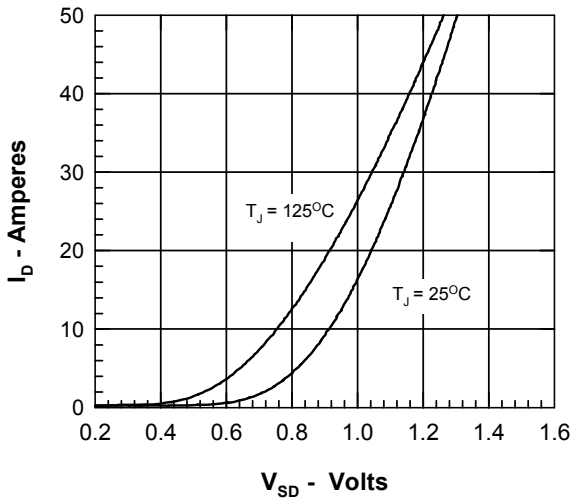


Figure 9. Source Current vs. Source to Drain Voltage

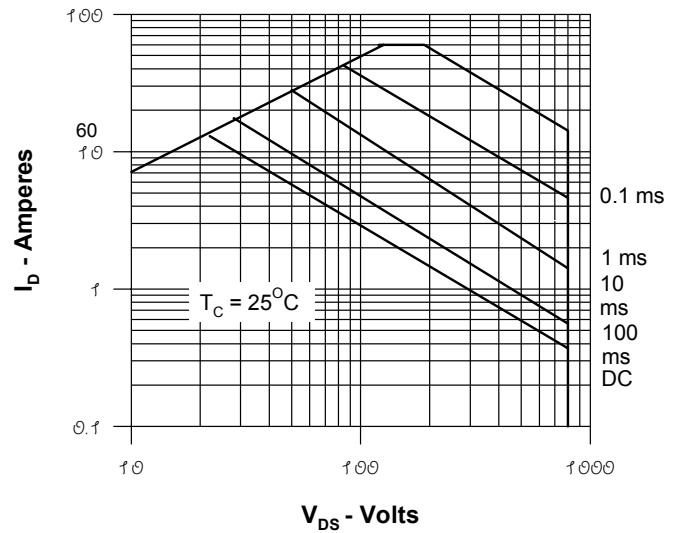


Figure 10. Forward Bias Safe Operating Area

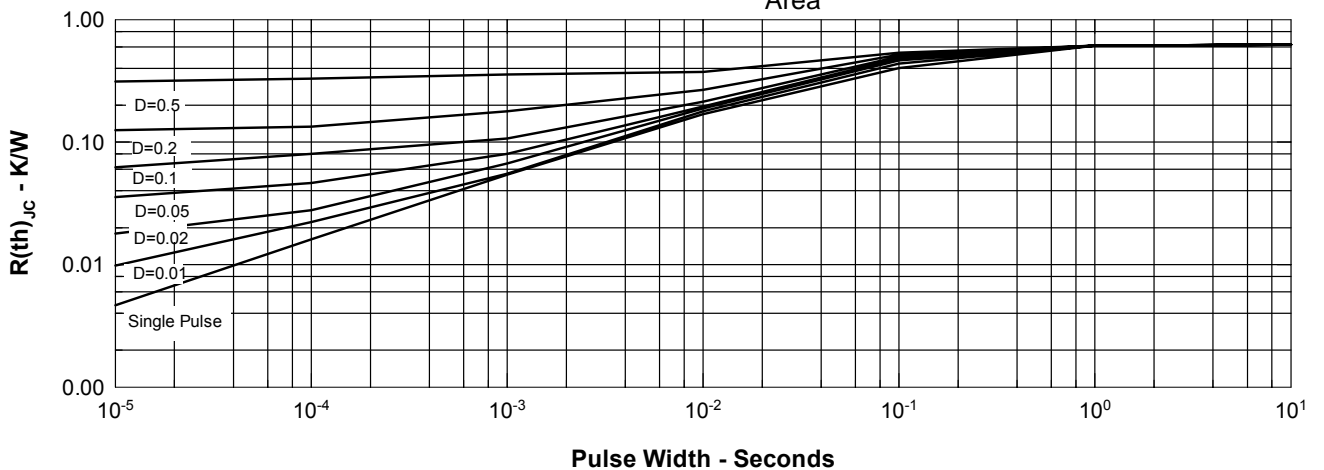


Figure 11. Transient Thermal Resistance



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.